

株式会社バイ・テクノロジー

2024年3月期(第27期) 第1四半期決算

補足説明資料

2023年8月10日

全社連結業績サマリー

- ▶ 主にFPD装置需要の低迷から、前期比で減収減益
- ▶ 通期見通しに対して概ね想定通りの進捗、通期業績予想の変更無

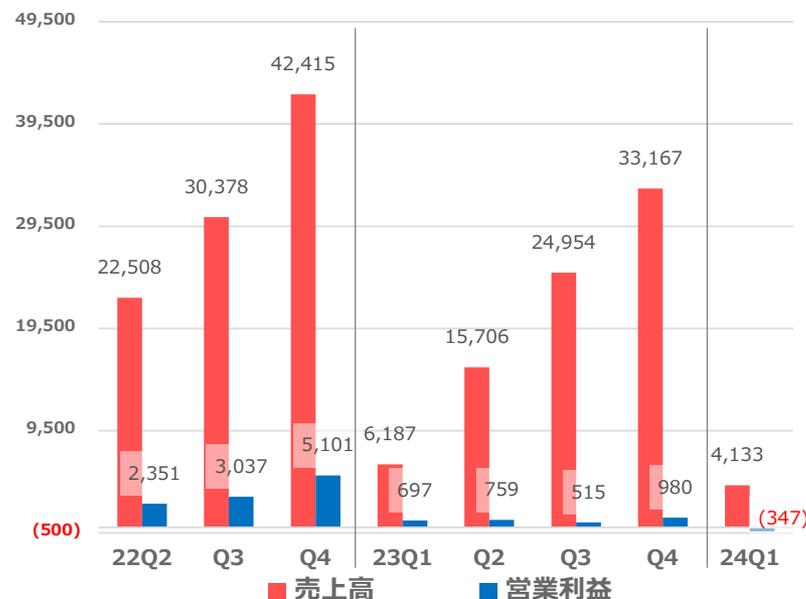
(百万円)	2023年3月期Q1		2024年3月期Q1		
	金額	構成比	金額	構成比	前年同期比
売上高	7,795	100.0%	5,749	100.0%	▲26.2%
売上総利益	2,582	33.1%	1,870	32.5%	▲27.6%
営業利益(損失▲)	452	5.8%	▲641	—	—
経常利益(損失▲)	1,098	14.1%	▲410	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益(損失▲)	719	9.2%	▲406	—	—

各セグメントの連結売上高・営業利益の状況

半導体・ フォトマスク* ₁	23年3月Q1	24年3月Q1	YoY
売上高	1,322	1,377	+4.2%
営業損失 (セグメント利益率)	▲197 (-%)	▲204 (-%)	-%

FPD* ₂	23年3月Q1	24年3月Q1	YoY
売上高	6,187	4,133	▲33.2%
営業利益(損失▲) (セグメント利益率)	697 (11.3%)	▲347 (-%)	-%

(単位：百万円)



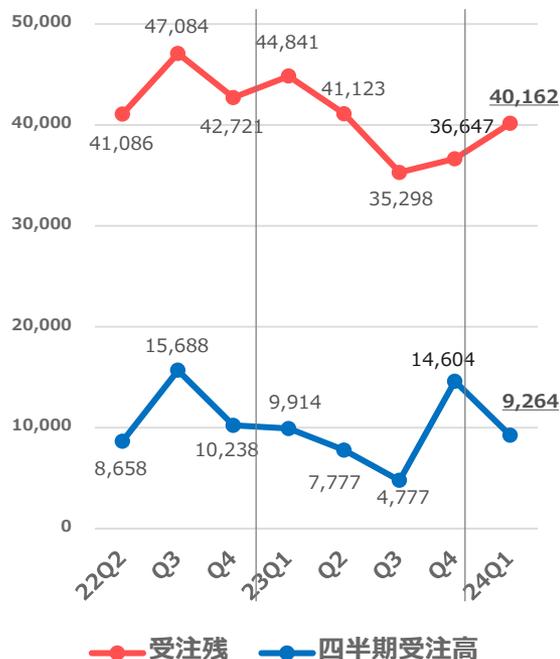
*1 半導体・フォトマスク装置事業：半導体製造工程における製造装置、検査装置及びフォトマスク用装置等の開発、設計、製造、販売、関連サービスで構成

*2 FPD装置事業：FPD製造工程における製造装置、検査装置等の開発、設計、製造、販売、関連サービス及びOLED用蒸着マスクをはじめとする部材等で構成

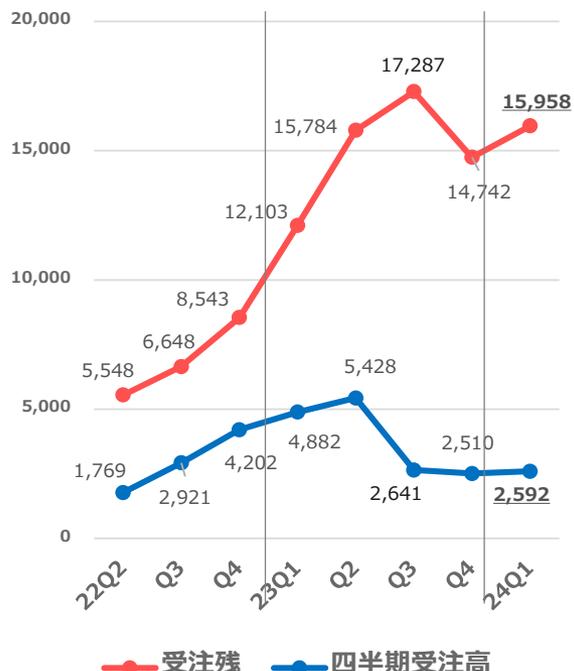
全社およびセグメント別の連結受注高・受注残の状況 (単位：百万円)

- ▶ 半導体・フォトマスク：Siウェハ関係の商談が低調ながら他製品の引合いは増加傾向
- ▶ FPD：既存工場の生産能力増強に関連した商談の成約

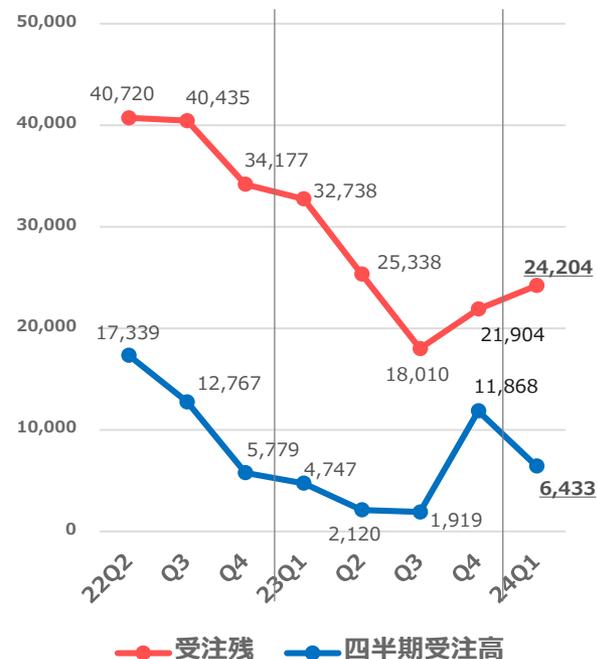
全社	23年Q1	24年Q1	YoY
受注(3カ月)	9,914	9,264	▲6.6%
受注残	44,841	40,162	▲10.4%



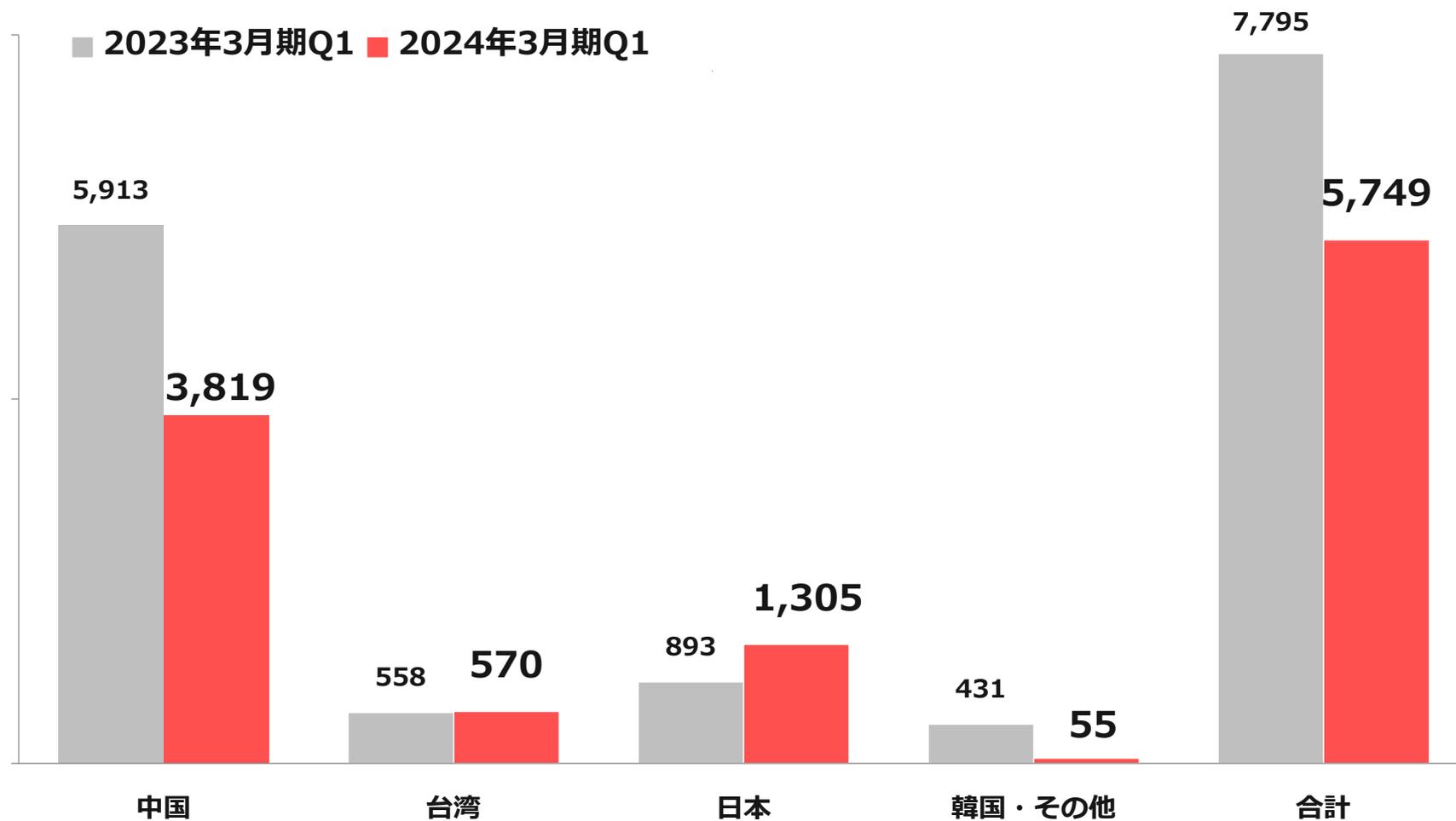
半導体・フォトマスク	23年Q1	24年Q1	YoY
受注(3カ月)	4,882	2,592	▲46.9%
受注残	12,103	15,958	▲31.9%



FPD	23年Q1	24年Q1	YoY
受注(3カ月)	4,747	6,433	▲35.5%
受注残	32,738	24,204	▲26.1%



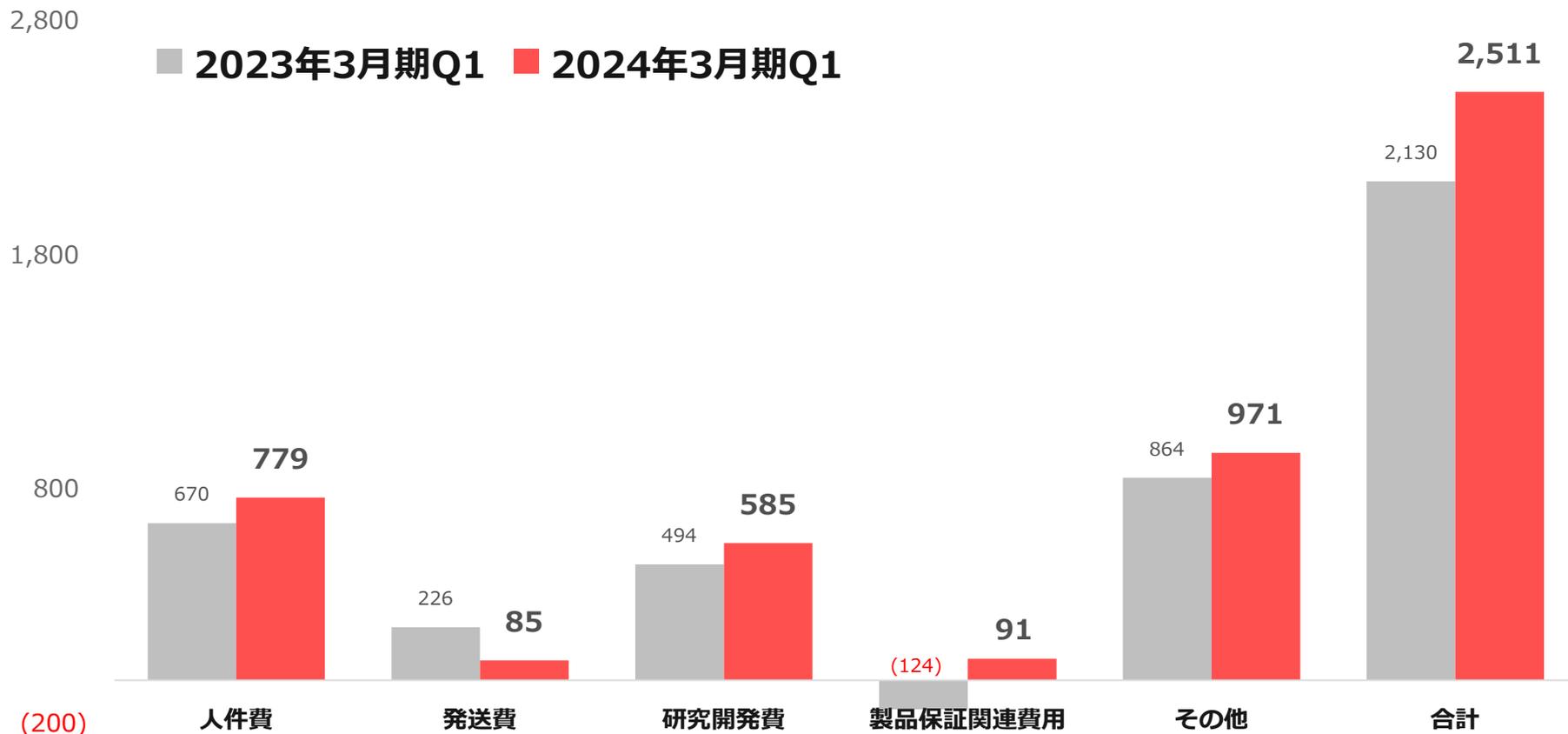
(参考) 地域別連結売上高 (単位: 百万円)



販売費及び一般管理費

(単位：百万円)

▶ 製品保証引当金、半導体向け製品開発、子会社増の影響から前期比381百万円増加



(参考) 四半期毎連結売上高・利益の推移

(百万円)

24,300

19,300

14,300

9,300

4,300

(700)

2021年3月期

2022年3月期

2023年3月期

2024
Q1

50.0%
(利益率)

40.0%

30.0%

20.0%

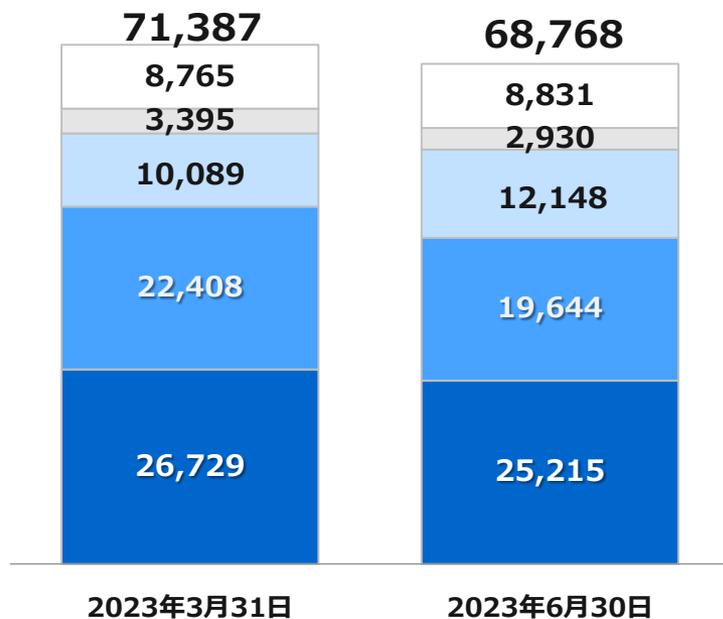
10.0%

0.0%

	21 Q1	21 Q2	21 Q3	21 Q4	22 Q1	22 Q2	22 Q3	22 Q4	23 Q1	23 Q2	23 Q3	23 Q4	24 Q1
■ 売上高(百万円)	10,297	17,923	13,278	13,688	13,094	14,033	9,690	14,601	7,795	11,494	10,603	13,254	5,749
■ 売上総利益(百万円)	3,173	4,161	4,312	4,058	3,687	3,622	3,215	4,962	2,582	2,501	2,121	3,742	1,870
■ 営業利益(百万円)	1,169	1,771	2,052	1,612	1,312	1,230	772	2,147	452	133	▲ 466	867	▲ 641
▲ 売上総利益率	30.8%	23.2%	32.5%	29.6%	28.2%	25.8%	33.2%	34.0%	33.1%	21.8%	20.0%	28.2%	32.5%
■ 営業利益率	11.4%	9.9%	15.5%	11.8%	10.0%	8.8%	8.0%	14.7%	5.8%	1.2%	—	6.5%	—

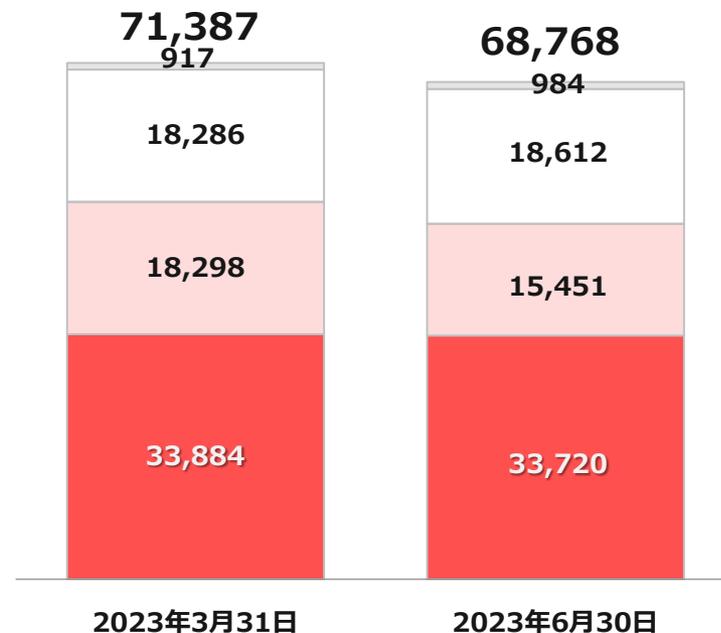
連結貸借対照表の推移

総資産
(単位：百万円)



■ 現金及び預金 ■ 受取手形及び売掛金 ■ 棚卸資産
■ 其他流動資産 ■ 固定資産

負債・純資産
(単位：百万円)



■ 純資産 ■ 借入金（短期・長期） ■ 其他流動負債 ■ 其他固定負債

| 通期業績及び配当の予想

通期業績及び配当予想

- ▶ Q2を底に下期の業績回復を予想、業績および配当予想の変更無し
 - ・ 設備投資が下期偏重でありQ1売上進捗は14%ながら計画通りの推移

(百万円)	2023年3月期実績		2024年3月期 業績および配当の予想 (2023/5/12時点)		
	金額	構成比	金額	構成比	前期比
売上高	43,146	100.0%	40,000	100.0%	▲7.3%
営業利益	986	2.3%	1,000	2.5%	+1.4%
経常利益	1,700	3.9%	850	2.1%	▲50.0%
親会社株主に 帰属する当期純利益	260	0.6%	550	1.4%	+111.3%
EPS(円)	26.92		56.88		—
配当(円)	中間	60円	30円		▲30円
	期末	30円	30円		—

| トピックス

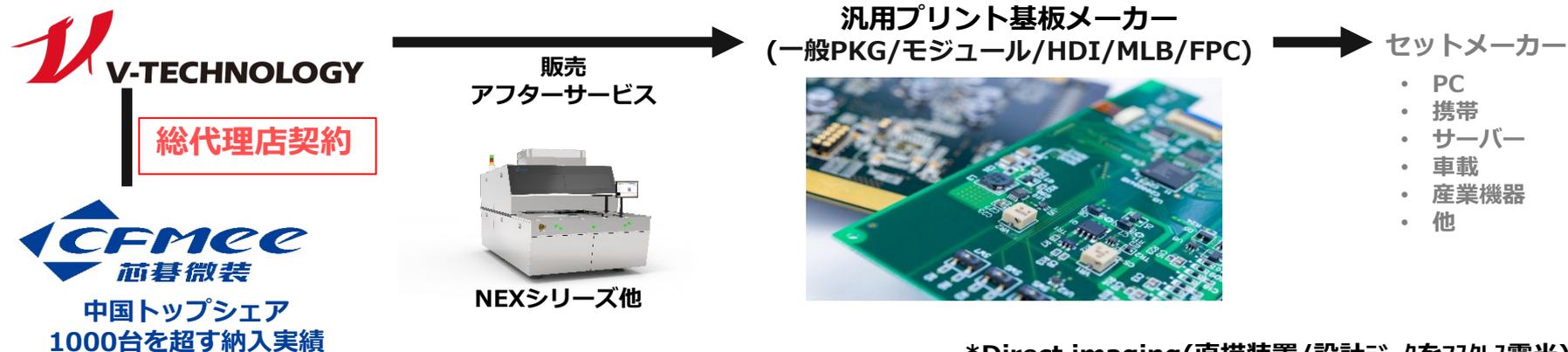
アドバンスドパッケージ市場・汎用プリント基板市場に本格参入

- ▶ **DI*露光装置の販売を開始、JPCA Showに出展(6/30~7/2)**
 - ▶ 合併会社LE-TECHNOLOGYを設立、両社技術を活用しアドバンスドパッケージ市場に参入
 - ▶ CFMEEと総代理店契約を締結、汎用パッケージ市場に参入

アドバンスドパッケージ市場



汎用プリント基板市場



*Direct imaging(直描装置/設計データをマスクに露光)

注記事項

▶ 将来見通し

本資料に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待、見積、予想に基づいています。これらの期待、見積、予想は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる結果となる可能性があります。従って、これら将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えて頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

▶ 数字の処理

記載された金額は、単位未満を切り捨て処理、比率は単位金額で処理した結果を四捨五入している為、内訳と一致しない場合があります。

お問合せ先

社長室 IRグループ
vtj-mng-pre@vtec.co.jp

